

"ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА.**Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА"****Редакционный совет****Главный редактор**

Красников Г.Я., д.т.н., академик РАН

Члены редакционного совета

Аристов В.В., член-корреспондент РАН,

Асеев А.Л., д.ф.-м.н., академик РАН.

Бетелин В.Б., академик РАН, д.ф.-м.н.,

Бокарев В.П., к.х.н., ответственный секретарь,

Бугаев А.С., д.ф.-м.н., академик РАН.

Быков В.А., д.т.н.

Галиев Г.Б., д.ф.-м.н.

Горбачевич А.А. член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н.

Горнев Е.С., д.т.н., зам. главного редактора.

Грибов Б.Г., д.х.н., член-корреспондент РАН.

Зайцев Н.А., д.т.н.

Ким А.К., к.т.н.

Критенко М.И., к.т.н.

Немудров В.Г., д.т.н.

Орликовский А.А., д.т.н., академик РАН.

Петричкович Я.Я., д.т.н.

Сигов А.С., д.ф.-м.н., академик РАН.

Стемпковский А.Л., д.т.н., академик РАН.

Чаплыгин Ю.А., д.т.н., член-корреспондент РАН.

Шелепин Н.А., д.т.н. зам. главного редактора

Эннс В.И., к.т.н.

Адрес редакции

124460 г. Москва, Зеленоград,
1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1
☎ +7 495 229-70-43

✉ journal_EEM-3@mikron.ru

🌐 www.mikron.ru/journal

Журнал издается с 1965 года

Учредитель

АО "Научно-исследовательский
институт молекулярной
электроники"

РАЗРАБОТКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ**СЕМЕЙСТВО КНИ МИКРОСХЕМ ПЗУ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЕМКОСТЬЮ 4–64 МБИТ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ**

Г.Я.Красников, В.Д.Мещанов, Н.А.Шелепин 4–12

ПОВЫШЕНИЕ СБООУСТОЙЧИВОСТИ**СЛОЖНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ ОЗУ В КМОП СБИС**Ю.М.Герасимов, Н.Г.Григорьев, А.В.Кобыляцкий,
Я.Я.Петричкович 13–19**СОВРЕМЕННЫЕ КМОП КЛЮЧИ ДЛЯ СВЧ ДИАПАЗОНА**

В.В.Репин, М.Г.Дроздецкий, И.И.Мухин 20–31

РАЗРАБОТКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОММУТАТОРА**ДЛЯ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЕЙ (ПКС)**

Р.Л.Смелянский, В.В.Васин, С.О.Беззубцев 32–45

ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИЯ**АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОРНЫХ АРХИТЕКТУР**

Д.Б.Бычков, С.Ю.Дождев 46–51

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ ТИПА РСМ**

Г.Я.Красников, Н.А.Зайцев, А.Г.Красников, Ю.И.Плотников 52–60

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ**АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ НЕКЛАССИЧЕСКОГО КОМПЬЮТИНГА И ПАРАДИГМЫ КОННЕКЦИОНИЗМА**

Е.С.Горнев, И.В.Матюшкин, Г.С.Теплов 61–92

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ**ЛИТОГРАФИИ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ РИСУНКА И ИММЕРСИОННОЙ ЛИТОГРАФИИ 193-НМ ДЛЯ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 20 НМ**

П.Брандт, Ч.Сардана, Д.Ибботсон, М.Виланд, О.Фау 93–104

НАДЕЖНОСТЬ**КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА И РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ**

М.С.Темирбулатов, В.И.Эннс 105–121

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**ЗАЩИТА ВХОДОВ КМОП-КОМПАРАТОРОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЦП ОТ ЭФФЕКТА ОБРАТНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ СИГНАЛА**

Л.А.Антюфьева, Р.С.Михеев 122–126

АННОТАЦИИ

..... 127–130

"ELECTRONIC ENGINEERING. Series 3. MICROELECTRONICS"

Editorial Council

Chief Editor

G.Ya. Krasnikov, Sc.D., Full Member
of the RAS

The Members of Editorial Council

V.V. Aristov, Sc.D., Corresponding
Member of the RAS

A.L. Aseev, Sc.D., Full Member of the
RAS

V.B. Betelin, Sc.D., Full Member of
the RAS

V.P. Bokarev, Ph.D., Responsible
Secretary

A.S. Bugaev, , Full Member of the
RAS

V.A. Bykov, Sc.D.

G.B. Galiev, Sc.D.

A.A. Gorbatshevich, Sc.D.,
Corresponding Member of the RAS
E.S. Gornev, Sc.D., Deputy Chief
Editor

B.G. Gribov, Sc.D., Corresponding
Member of the RAS

N.A. Zaitsev, Sc.D.

A.K. Kim, Ph.D.

M.I. Kritenko, Ph.D.

V.G. Nemudrov, Sc.D.

A.A. Orlikovsky, Sc.D., Full Member
of the RAS

Ya. Ya. Petrichkovich, Sc.D.

A.S. Sigov, Sc.D., Full Member of the
RAS

A.L. Stempkovskiy, Sc.D., Full
Member of the RAS

Y.A. Chaplygin, Sc.D., Corresponding
Member of the RAS

N.A. Shelepin, Sc.D., Deputy Chief
Editor

V.V. Enns, Ph.D.

Editorial Staff Address

1-st Zapadny pr-d 12, str. 1.

Zelenograd, Moscow, 124460, Russian
Federation

Phone: +7 (495) 229-70-43

E-mail: journal_EEM-3@mikron.ru

<http://www.mikron.ru/journal>

Journal was published from 1965 year

Founder

Joint-Stock Company "Molecular
Electronic Research Institute"

DEVELOPMENT AND DESIGNING

FAMILY 4–64 MBIT ROM INTEGRATED CIRCUITS FOR SPACE APPLICATIONS

G.Ya.Krasnikov, V.D.Meschanov, N.A.Shelepin 4–12

IMPROVEMENT OF SRAM IP-BLOCKS HEAVY ION TOLERANCE IN BULK CMOS ASICS

Y.M.Gerasimov, N.M.Grigoryev, A.V.Kobylyatskiy, Y.Y.Petrichkovich13–19

MODERN CMOS MICROWAVE SWITCHES

V.V.Repin, M.G.Drozdetsky, I.I.Mukhin20–31

DEVELOPMENT OF THE FIRST RUSSIAN SDN-SWITCH

R.Smeliansky, V.Vasin, S.Bezzubtsev 32–45

PROCESSES AND TECHNOLOGY

ASPECTS OF PROCESSOR ARCHITECTURES PERFORMANCE METRICS

D.B.Bychkov, S.Y.Dozhdev 46–51

PROPERTIES OF MATERIALS

CONTEMPORARY SITUATION

IN THE FIELD OF NON-VOLATILE MEMORY DEVELOPMENT

G.Ya.Krasnikov, N.A.Zaytsev, A.G.Krasnikov, Y.I.Plotnikov52–60

MATHEMATICAL SIMULATION

NON-CLASSICAL COMPUTING CONCEPTS AND CONNECTIONISM PARADIGM ANALYSIS.

E.S.Gornev, I.V.Matyushkin, G.S.Teplov61–92

COMPARISON BETWEEN E-BEAM DIRECT WRITE AND IMMERSION LITHOGRAPHY FOR 20 nm NODE

P.Brandt, C.Sardana, D.Ibbotson, M.Wieland, A.Fay93–104

RELIABILITY

SPACE PROGRAM AND RADIATION HARDNESS OF MODERN IC'S

M.S.Temirbulatov, V.I.Enns 105–121

WORKS OF STUDENTS

REDUCING KICKBACK NOISE ON CMOS COMPARATOR'S INPUTS IN PARALLEL ADC

L.Antyufrieva, R.Mikheev 122–126

ABSTRACTS 127–130